

**Universidade de Pernambuco**  
**Programa de Pós-Graduação em Engenharia da**  
**Computação (PPGEC)**

**Proposta de Dissertação de Mestrado**

**Área: Inteligência Computacional**

**Título: Modelagem Preditiva do Comportamento Térmico de GPUs sob Cargas de Trabalho de Deep Learning**

**Orientador: Sérgio Murilo Maciel Fernandes ([sergio.fernandes@upe.br](mailto:sergio.fernandes@upe.br))**

**Coorientador: Sidney Marlon Lopes de Lima ([sidney.lima@ufpe.br](mailto:sidney.lima@ufpe.br))**

**Descrição** – A ascensão de Large Language Models (LLMs) impôs uma pressão sem precedentes sobre a infraestrutura de hardware, transformando o consumo de energia e a dissipação térmica em gargalos críticos para a escalabilidade da Inteligência Artificial [2]. Diferente de cargas de trabalho computacionais tradicionais, o treinamento de modelos massivos gera flutuações de potência que levam as GPUs ao seu limite térmico (Thermal Design Power - TDP), disparando frequentemente o Thermal Throttling [2], [4]. Este fenômeno reduz a frequência de operação dos núcleos, resultando em uma degradação severa da vazão de processamento e aumentando significativamente o custo operacional (TCO) de grandes data centers, por exemplo [2], [4].

Historicamente, a modelagem térmica dependia de simulações de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD), que, embora precisas, possuem um custo computacional proibitivo para decisões em tempo real [5]. Trabalhos recentes de alto impacto propõem a transição para modelos substitutos (*surrogate models*) baseados em Deep Learning, como os Operadores Neurais de Fourier (FNO), que conseguem prever distribuições térmicas 3D com uma velocidade aos métodos tradicionais [5]. Além disso, a integração de leis da física com aprendizado de dados (técnicas como LEnPOD-GP) permitiu o mapeamento de *hotspots* dinâmicos em GPUs de muitos núcleos (como a arquitetura NVIDIA Volta/Hopper) [1].

Apesar desses avanços, a literatura recente aponta que o gerenciamento térmico reativo é insuficiente para lidar com a volatilidade de modelos de IA modernos [2], [4]. Pesquisas publicadas em fóruns de elite sugerem que o escalonamento de tarefas consciente da temperatura (*Thermal-aware Scheduling*) pode reduzir o pico térmico em até 12°C e os custos de resfriamento pela metade [3], [6]. No entanto, a fusão eficiente entre telemetria de hardware em tempo real (obtida via NVML) e o comportamento estocástico das fases de treinamento (como *feedforward* vs *backpropagation*) ainda carece de modelos preditivos robustos e generalizáveis para ambientes privados, nuvem e edge [3], [6].

Este projeto propõe investigar e desenvolver um *framework* de modelagem preditiva que utilize redes neurais recorrentes (LSTMs) para antecipar o comportamento térmico de GPUs sob cargas de DL. A pesquisa focará na correlação entre hiperparâmetros de software (como *batch size*) e o estresse térmico do hardware [2], [4]. Espera-se que a solução proposta permita uma orquestração proativa, otimizando a eficiência energética (Performance-per-Watt) e estendendo a vida útil dos hardwares de alto desempenho [3], [5].

**Referências Bibliográficas**

- [1] L. Jiang, Y. Liu, and M.-C. Cheng, "Effective thermal modeling for large-scale many-core gpus using local physics-based data-learning approach," *Structural and Multidisciplinary Optimization*, vol. 68, 2025.
- [2] P. Patel, E. Choukse, C. Zhang, Í. Goiri, B. Warriar, N. Mahalingam, and R. Bianchini, "Characterizing power management opportunities for llms in the cloud," *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*, Volume 3, 2024.
- [3] S. Ilager, K. Ramamohanarao, and R. Buyya, "Thermal prediction for efficient energy management of clouds using machine learning," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 32, pp. 1044–1056, 2020.
- [4] J. Stojkovic, C. Zhang, Í. Goiri, E. Choukse, H. Qiu, R. Fonseca, J. Torrellas, and R. Bianchini, "Tapas: Thermal- and power-aware scheduling for llm inference in cloud platforms," *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*, Volume 2, 2025.



- [5] S. Sarkar, A. Guillen-Perez, Z. Carmichael, A. Naug, R. M. Çam, V. Gundecha, A. R. Babu, S. Ghorbanpour, and R. L. Gutiérrez, "Fast 3d surrogate modeling for data center thermal management," 2025.
- [6] T. Tan and G. Cao, "Thermal-aware scheduling for deep learning on mobile devices with npu," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 23, pp. 10706–10719, 2024.